

信頼性試験結果
Reliability Test

XC8108シリーズ

XC8108 Series

 パッケージ : USP-6C

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen & Antimony-Free

| No. | 試験項目 Test Item | 試験条件 Test Conditions | 時間 Hours | 試験結果 Result r/n |
|-----|--|--|-------------|-----------------------|
| 1 | 高温バイアス High Temperature Bias | 125°C VIN=6.3V | 1000 | 0/22 |
| 2 | 高温保存 High Temperature Storage | 150°C | 1000 | 0/22 |
| 3 | 高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias | 85°C85%RH VIN=6.3V | 1000 | 0/22 |
| 4 | 温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous) | -65°C~150°C 各30分 30min Each | 100CYC. | 0/22 |
| 5 | プレッシャークッカー UHASt | 125°C85%RH 2×10 ⁵ Pa | 100 | 0/22 |
| 6 | はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat | 85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times →85°C85%RH24h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)1time Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020D | | 0/22 |
| 7 | 静電耐圧 Electric Static Discharge. | R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回 ±200V over 3times Each | | 0/20 |
| | | R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 各端子3回 ±1kV over 3times Each | | |
| 8 | ラッチアップ Latch-Up | R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回 ±100V over 3times Each | | 0/5 |
| | | 50mA以上 50mA over | | |

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

| No. | 試験項目 Test Item | 試験条件 Test Conditions | 試験結果 Result r/n |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 接合強度試験 Adhesive strength test | PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec. | 0/5 |
| 2 | 基板反り試験 Bending Test | たわみ量 5mm 5±1s 1回/1time (EIAJ ED4702) Strain | 0/5 |
| 3 | はんだ付け性 Solderability | 230°C10秒(プロファイル昇温法) 10s (Temperature profile method) | 0/11 |